



Press release
Communiqué de presse
Comunicato stampa
新聞稿 / 新聞稿
プレスリリース
 보도자료

※本リリースは2021年6月24日に発表されたリリースを翻訳したものです

STマイクロエレクトロニクス、イタリアで建設中の300mmアナログ、パワー半導体用ファブ でタワーセミコンダクターとの協業を発表

STのアグラテ R3 300mmファブの量産立ち上げ加速で連携

スイス、ジュネーブおよびイスラエル ミグダル ハエメク 2021年6月24日-多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス (NYSE : STM、以下ST) と高付加価値のアナログ半導体ファブソリューションのリーダーである[タワーセミコンダクター](#) (NASDAQ/TASE:TSEM)は本日、イタリアのアグラテ プリアンツァサイトで建設中のアグラテR3 300mmファブにタワーを迎え入れる契約を発表しました。STとタワーは、高い稼働率、そしてそれによる競争力のあるウェハコストを実現するためのキーファクターとなるファブの立ち上げを加速するために協業します。STはR3クリーンルームを提供し、タワーは全スペースの3分の1に自社設備を設置します。同ファブは今年後半に設備設置の準備が整い、2022年後半に生産を開始する見込みです。

STとタワーはクリーンルームスペースと施設インフラを共有します。両社はそれぞれのプロセス用の装置に投資し、ファブ認証の加速とその後の立ち上げは協力しながら進めます。STがオペレーションを継続し、特定の役割を担うタワーの担当者STに派遣し、ファブ認証および量産立ち上げ、およびその他のエンジニアリング、プロセス構築をサポートします。初期段階として、スマートパワー、アナログミックスドシグナル、およびRFプロセス向けの130、90および65nmプロセスが、R3で認証される予定です。これらの技術を使った製品は、特に自動車、産業用、パーソナルエレクトロニクスアプリケーションで使用されます。

STマイクロエレクトロニクスのプレジデント兼CEOのJean-Marc Chéryは次のように述べています。「ファブの産業的および経済的パフォーマンスの重要なパラメーターは、その稼働率です。タワーは、我々にとってアナログ、パワー、ミックスドシグナルの量産に向けた優れたパートナーであり、アグラテのR3 300mmファブの認証と立ち上げを早期に実現することができるようになります。これにより、生産の初期段階からほぼ確実に最適な稼働率を維持することが可能になるでしょう。プロジェクトを開始した2018年当初の生産能力推定値と比較して、ファブの完全なビルドアウト状態の生産能力をさらに増やすこともできます。アグラテ R3で製造された製品は、自動車、産業用、パーソナルエレクトロニクス市場を支えます。中長期的には、幅広いアプリケーションで供給のひっ迫緩和に貢献します。」

タワーのCEO、Russell Ellwangerは次のように述べています。「STマイクロエレクトロニクス社とのこのようなパートナーシップを発表できることを非常に嬉しく思います。STの最先端テクノロジー、優れたオペレーション、そしてコーポレートインテグリティはよく知られています。両社の成功を期待しています。タワーの先端65nm、300mmベースのアナログRF、パワーブラットフォーム、ディスプレイ、その他の技術における強固な実行力は、アグラテでのこの活動によってさらに強化されるでしょう。タワーの300mmファブキャパシティを3倍以上に増やし、急成長するこれらの市場でお客様の高まる需要に対応します。」

本プロジェクトを遂行するために、タワーはイタリアの完全子会社を設立します。また、プロジェクトの進行に伴い、重要な設備投資スケジュールと投資額の詳細を発表します。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約46,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な独立系総合半導体メーカーです。約10万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、IoT・5G通信の普及を可能にします。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト (www.st.com) をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM, TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーで、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル /CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント (BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点ががあります。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

Contacts

STMicroelectronics

Investor Relations
Céline Berthier
Group VP, Investor Relations
Tel: +41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com

Media relations
Alexis Breton
Corporate External Communications
Tel: + 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com

Tower Semiconductor

Investor Relations Contact:
Noit Levi | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com